

podtrzymującą oczyszczane złoże (3), od dołu połączoną z rurociągiem (4) sprzężonym z dmuchawą (5), którego przestrzeń wewnętrzna połączona jest z generatorem (8) ozonu. Pomiedzy generatorem (8) ozonu, a reaktorem (1) wbudowana jest, jako fragment rurociągu (4), płuczka (5) z zalkalizowaną wodą do pH 10. Drugie rozwiązanie tego urządzenia ma przed wlotem do dmuchawy usytuowany ultradźwiękowy wytwarzacz aerozolu wody.

(4 zastrzeżenia)

A1 (21) 403373 (22) 2013 03 29

(51) B23K 35/36 (2006.01)
B23K 35/362 (2006.01)
B23K 35/363 (2006.01)

(71) INSTYTUT TELE-I RADIOTECHNICZNY,
Warszawa
(72) KOŚCIELSKI MAREK; RAFALIK IRENEUSZ;
SITEK JANUSZ; KAROLEWSKI SEBASTIAN

(54) Topnik typu no-clean do lutowania selektywnego

(57) Topnik (typu no-clean) do lutowania selektywnego, charakteryzuje się tym, że zawiera rozpuszczalnik, korzystnie propan-2-ol i/lub kwas karboksylowy i/lub kwasy kalafonii, oraz amid organiczny w ilości co najwyżej 20%.

(1 zastrzeżenie)

A1 (21) 403443 (22) 2013 04 05

(51) B23P 17/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków
(72) KAWECKI ARTUR; KNYCH TADEUSZ;
MAMALA ANDRZEJ; KWAŚNIEWSKI PAWEŁ;
KIESIEWICZ GRZEGORZ; SMYRAK BEATA;
SIEJA-SMAGA ELIZA

(54) Sposób wytwarzania drutów ze stopów Cu-Ag

(57) Sposób wytwarzania drutów, w tym mikrodrutów, ze stopów Cu-Ag, zwłaszcza ze stopów Cu-(3÷7,9)%wag. Ag, polega na tym, że materiały w postaci miedzi i srebra o wysokiej czystości chemicznej poddawane są procesowi topienia w temperaturze 1083÷1300°C w tyglu grafitowym umieszczonym w piecu, a następnie procesowi odlewania ciągłego w temperaturze 1083÷1300°C, w atmosferze gazu obojętnego przy zastosowaniu krystalizatora grafitowego, w warunkach chłodzenia pierwotnego (chłodzenie krystalizatora) oraz wtórnego (zakrzepniętego stopu po wyjściu z krystalizatora). Tak otrzymany odlew poddany jest obróbce cieplno-mechanicznej.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 403444 (22) 2013 04 05

(51) B23P 17/04 (2006.01)

(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE,
Kraków
(72) KAWECKI ARTUR; KNYCH TADEUSZ;
MAMALA ANDRZEJ; KWAŚNIEWSKI PAWEŁ;
KIESIEWICZ GRZEGORZ; SMYRAK BEATA;
SIEJA-SMAGA ELIZA

(54) Sposób wytwarzania drutów ze stopów Cu-Ag

(57) Sposób wytwarzania drutów, w tym mikrodrutów, ze stopów Cu-Ag, zwłaszcza ze stopów Cu-(8÷15)% wag. Ag, polegający na tym, że materiały w postaci miedzi i srebra o wysokiej czystości chemicznej poddawane są procesowi topienia w temperaturze 1083÷1300°C w tyglu grafitowym umieszczonym w piecu, a następnie procesowi odlewania ciągłego w temperaturze 1083÷1300°C, w atmosferze gazu obojętnego przy zastosowaniu krystalizatora grafitowego, w warunkach chłodzenia pierwotnego (chłodzenie

krystalizatora) oraz wtórnego (zakrzepniętego stopu po wyjściu z krystalizatora). Tak otrzymany odlew poddany jest obróbce cieplno-mechanicznej.

(15 zastrzeżeń)

A1 (21) 403506 (22) 2013 04 11

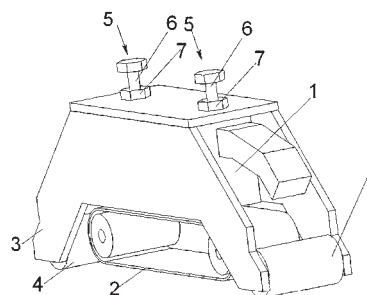
(51) B24B 23/08 (2006.01)
B24B 23/06 (2006.01)
B24B 21/02 (2006.01)
B29D 30/52 (2006.01)

(71) SZAFRAŃSKI PIOTR, Warszawa
(72) SZAFRAŃSKI PIOTR

(54) Urządzenie do naprawy opon

(57) Urządzenie do naprawy opon, zawiera element ścierny, który stanowi pas szlifierski (2) szlifierki taśmowej (1). Szlifierka taśmowa (1) z pasem szlifierskim (2) osadzona jest ruchomo w ramie prowadzącej (3).

(8 zastrzeżeń)



A1 (21) 403446 (22) 2013 04 05

(51) B27M 3/18 (2006.01)
A47B 96/20 (2006.01)

(71) TABESKO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
Łódź
(72) POROWSKI JAN

(54) Płyta meblowa i sposób wytwarzania płyt meblowych

(57) Sposób wytwarzania płyt meblowych, w którym na pierwszej warstwie okładziny powierzchni głównej z naniesionym na nią klejem układa się sztywną ramę, w której umieszcza się papierowe wypełnienie, po czym nakłada się na nie drugą warstwę okładziny powierzchni głównej z naniesionym na nią klejem i tak ułożone warstwy prasuje się uzyskując płytę o strukturze komórkowej charakteryzuje się tym, że ramiaki (21-24) ramy (20) szlifuje się do znormalizowanej wysokości (h1) od 10mm do 60mm, a papierowe wypełnienie (30) przygotowuje się w postaci wstęgi tak, że z arkuszy tektury falistej wycina się, w kierunku prostopadłym do kierunku fali, paski o szerokości większej od wysokości (h1) ramiaków (21-24) o wielkość do 0,5mm, które to paski łączą się we wstęgę, przy czym wstęgę układa się kierunkiem fali prostopadle do okładzin (11, 12)

